

锦州神工半导体股份有限公司

2022 年年度股东大会

会议资料



二〇二三年四月

目录

锦州神工半导体股份有限公司 2022 年年度股东大会会议须知.....	3
锦州神工半导体股份有限公司 2022 年年度股东大会会议议程.....	6
议案一： 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》	8
议案二： 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	9
议案三： 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	19
议案四： 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	22
议案五： 《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》	26
议案六： 《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	28
议案七： 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	29
议案八： 《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》	30
议案九： 《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》	31
议案十： 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	32

锦州神工半导体股份有限公司

2022 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《锦州神工半导体股份有限公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年年度股东大会会议须知：

一、本次股东大会由董事会秘书协调组织，公司证券办公室严格按照程序安排会务工作。为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，会议登记应当终止。

二、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以在本次会议通知规定的网络投票时间里通过会议通知上列明的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应提前向股东大会会务组进行登记。股东大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者先

发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不宜过长。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场进行见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议政策程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023 年 3 月 18 日披露于上海证券交易所网站的《锦州神工半导体股份有限公司关于

召开 2022 年年股东大会的通知》。

锦州神工半导体股份有限公司

2022 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 会议时间：2023 年 4 月 10 日（周一）14:00

(二) 会议地点：锦州市太和区中信路 46 号甲公司会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料；

(二) 会议主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数、介绍现场会议参会人员、列席人员；

(三) 宣读股东大会会议须知；

(四) 推举计票、监票成员；

(五) 审议会议议案：

- 1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
- 2、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
- 3、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
- 6、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
- 7、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
- 8、《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》
- 9、《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

- (六) 与会股东或股东代表发言、提问；
- (七) 与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决；
- (八) 休会，统计现场表决结果；
- (九) 复会，主持人宣布会议表决结果；
- (十) 见证律师宣读关于本次股东大会的法律意见书；
- (十一) 与会人员签署会议记录等相关文件；
- (十二) 会议结束。

议案一：

《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

各位股东和股东代表：

公司已于 2023 年 3 月 18 日披露了《锦州神工半导体股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要，具体内容可在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》查阅。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

议案二：

《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

各位股东和股东代表：

一、2022 年公司经营情况讨论与分析

2022 年，全球经济增长受到地缘政治军事冲突以及区域性能源危机的不利影响：根据国际货币基金组织统计，全球经济增长率从 2021 年的 6.0% 下降至 2022 年的 3.2%；全球通胀率从 2021 年的 4.7% 飙升至 2022 年的 8.8%，达到数十年来高点，终端消费者市场需求受到较大冲击。全球经济大环境与半导体市场供求关系周期性变化的叠加，以及一些国家推出的半导体产业投资补贴政策和技术出口管制政策对供应链的扰动，造成了年内较为复杂多变的市场环境。

根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）2023 年 2 月发布的数据，2022 年全球半导体市场规模为 5,735 亿美元，同比增长 3.2%，创下历史新高。公司认为，这显示全球经济“数字化”、“低碳化”转型所推动的半导体市场长期需求仍然强劲；另一方面，自 2022 年第二季度以来，个人电脑、智能手机等终端市场出货量下滑，下游库存攀升，首先影响英特尔、三星电子等公司，并逐步向产业纵深蔓延。WSTS 数据显示，全球半导体市场 2022 年第四季度销售总额为 1,302 亿美元，同比下滑 14.7%，环比下滑 7.7%。公司扎根于分工严密的国际半导体供应链中，所处硅材料细分行业在整个半导体产业链上游，经营业绩与上述数据所呈现的半导体行业景气度仍高度相关。

报告期内，公司克服种种不利影响，持续优化了产品结构、按计划扩大生产规模，进一步完善了产品技术指标和销售网络，再次创造了年度营收新高，实现营业收入 53,923.65 万元，比去年同期增长 7.09%；2022 年公司主要原材料原始多晶硅原料价格持续上涨，比 2021 年升高超过 1 倍以上，同时公司硅零部件和半导体大尺寸硅片业务仍处于开拓期，研发费用等投入较多，尚未能够贡献盈利。以上双重原因导致公司在 2022 年营收增长的同时，净利润有所下降。归属于上市公司股东的净利润 15,814.16 万元，比去年同期下降 28.44%。

从产业链角度分析，公司的大直径硅材料产品，直接销售给日本、韩国等国的知名硅零部件厂商，后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备厂商，例如美国泛林集团（Lam Research）和日本东电电子（Tokyo Electron Limited, TEL），并最终销售给三星电子、英特尔和台积电等国际知名集成电路制造厂商。根据上述国际主流刻蚀机设备厂商和集成电路制造厂商披露的财务数据，目前下游库存调整仍在进行中，集成电路制造厂商产能利用率下滑，相应造成上游材料采购数量和交期调整，影响存量市场。公司下游半导体设备制造厂商遭遇零部件短缺问题，导致其积压订单高企并调整交期，一定程度上影响公司增量市场。另一方面，报告期内，公司的硅零部件产品、半导体大尺寸硅片产品两项业务收入明显提升，均达到千万元以上规模。以上产品主要面向中国市场销售，已经在中国本土供应链安全建设中发挥独特作用，伴随国产等离子刻蚀机设备厂商及集成电路制造厂商的崛起，公司将获得更大的成长空间和更强的成长动能。

从公司经营角度分析，2022 年公司主要上游原材料原始多晶硅原料的市场价格涨幅较大，影响公司大直径硅材料产品的毛利率水平。公司新业务硅零部件及半导体大尺寸硅片相关固定资产进入折旧期，加之年内新产品评估认证需求较大，研发费用和管理费用先期投入，一定程度上影响了公司的期间费用率。公司研发费用为 3,937.59 万元，及时满足了客户评估认证需求，相关研发项目结题后，推动公司新业务进入快速发展期。

面对外部市场环境风云变幻，公司管理层在报告期内坚定执行长期发展战略和既定年度经营计划。公司具体经营成果总结如下：

（一）国内外市场拓展成果

大直径硅材料业务，目前公司大直径多晶硅材料及其制成品已经通过部分客户认证并实现稳定出货，销售规模有望持续提高。

硅零部件业务，公司配合国内刻蚀机设备原厂开发的硅零部件产品，适用于 12 英寸等离子刻蚀机，已有十余个料号通过认证并实现小批量供货，同时能够满足刻蚀机设备原厂不断提升的技术升级要求。公司产品的认证应用范围，正在从研发机型扩展至某些成熟量产机型。公司在数家 12 英寸集成电路制造厂商已有十余个料号获得评估认证通过结果。完成评估认证的产品，在集成电路制造厂商相应料号中所占据的采购份额持续提升。

半导体大尺寸硅片业务，公司某款硅片已定期出货给某家日本客户，已经是国内数家集成电路制造厂商 8 英寸测试片的合格供应商。技术难度较高的氧化片、8 英寸轻掺低缺陷超平坦硅片等硅片产品在国内主流客户端评估中进展顺利。

（二）扩产完成情况

大直径硅材料业务，公司根据直接客户订单数量并结合行业的需求增速，按计划扩充产能，经过一年来的有序扩产，2022 年末达到约 500 吨/年，继续保持该细分市场产能规模全球领先地位；硅零部件业务，公司在泉州、锦州两地扩大生产规模，实现了较快速度的产能爬升，目前生产车间设计产能处于国内领先地位。

（三）研发成果

公司的研发投入以盈利为根本目标，基于下游客户端具体明确的评估认证要求来开展研发活动，报告期内取得核心技术 7 项，获得发明专利 1 个，实用新型专利 16 个。

大直径硅材料业务，公司在大直径多晶硅材料及其制成品生产技术方面获得了长足的进步，取得了更多试验数据，研发取得了一项多晶硅晶体生长控制核心技术，晶体良品率持续提高。

硅零部件业务，公司针对超平面空间结构，已经开发出多款适配终端客户需求的硅零部件。加工工艺方面实现了优良的表面完整性，采用精密磨削工艺替代成本较高的研磨工艺，强化了定制开发能力，进一步满足下游客户的需求。

半导体大尺寸硅片业务，公司实现了多款技术难度较大、毛利率较高的轻掺低缺陷硅片细分产品研发。晶体生长技术方面，公司持续深入 8 英寸氮掺杂特殊晶体的基础工艺开发，全面掌握了特殊掺杂晶体内部缺陷的控制方法，可以满足客户对 BMD 等指标的苛刻要求。硅片加工技术方面，高温氩气退火技术增加了公司高质量轻掺硅片的产品规格。公司按计划进一步提高了对硅片表面的平坦度指标要求，研发取得两项控制硅片表面平坦度的核心技术，逐步提高产出率，能够持续满足下游客户需求。

（四）募投项目进展

公司募投项目“研发中心建设项目”已于 2022 年 2 月达到预定可使用状态并结项；“8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目”由于国内阶段性交通不

便，该项目涉及的设备采购、装机调试、物流运输等多重事项均受到一定程度滞后影响，导致公司募投项目进度不及原计划预期。为提高募集资金利用率，根据公司目前实际情况及市场需求，公司拟有计划、分步逐步投入该项目，故将该项目的达到预定可使用状态时间调整至 2024 年 2 月。

目前年产 180 万片所需要的生产设备已经全部订购完成，其中一期 5 万片/月的设备已达到规模化生产状态。二期订购的 10 万片/月的设备陆续进场并开展安装调试等工作。当前公司硅片产能正在逐步爬坡，产品大多数的技术指标和良率已经达到或基本接近业内主流大厂的水准。

二、董事会及各专门委员会日常工作情况

2022 年，公司董事会严格按照上市公司规范运作的监管要求，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，进一步完善法人治理结构，规范运作，认真落实股东大会各项决议，提升公司的风险防范能力和工作效率，保障公司经营活动的顺利进行。

（一）股东大会会议召开情况

2022 年度，公司召开 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 3 月 3 日	审议通过：1、关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案；2、关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案；3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 13 日	审议通过：1、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案；2、关于 2021 年度董事会工作报告的议案；3、关于 2021 年度监事会工作报告的议案；4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案；5、关于公司 2021 年度财务预算报告的议案；6、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案；7、关于 2022 年度公司董事薪酬方案的议案；8、关于 2022

		年度公司监事薪酬方案的议案。
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 9 月 15 日	审议通过：1、关于变更公司营业范围并修订《公司章程》的议案；2、关于补选董事的议案；3、关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案。

（二）董事会会议召开情况

2022 年度，公司召开 6 次董事会，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第四次会议	2022 年 2 月 14 日	审议通过 1、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 2、关于《公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案 4、关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案。
第二届董事会第五次会议	2022 年 3 月 3 日	审议通过 1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
第二届董事会第六次会议	2022 年 4 月 18 日	审议通过 1、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 2、关于 2021 年度董事会工作报告的议案 3、关于 2021 年度总经理工作报告的议案 4、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 5、关于公司 2022 年度财务预算报告的议案 6、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 7、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 8、关于 2022 年度董事薪酬方案的议案 9、关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案 10、关于公司 2021 年度募资资金实际存放与使用情况的专项报告的议案 11、关于注销部分募集资金专用账

		户的议案 12、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 13、关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案。
第二届董事会第七次会议	2022 年 4 月 25 日	审议通过 1、关于公司 2022 年第一季度报告的议案。
第二届董事会第八次会议	2022 年 8 月 29 日	审议通过 1、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于开展远期外汇交易业务的议案 4、关于向金融机构申请综合授信额度的议案 5、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 6、关于变更公司营业范围并修订<公司章程>的议案 7、关于补选董事的议案 8、关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案 9、关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案。
第二届董事会第九次会议	2022 年 10 月 25 日	审议通过 1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案。

（三）董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会均履行了专门委员会的职责，发挥了专门委员会的作用。专门委员会在内部控制有效性、定期报告编制、高级管理人员薪酬等事项方面进行了讨论和审议，在各自的专业领域发挥了重要作用，保证了董事会决策的科学性，提高了重大决策的质量。

三、公司发展战略

公司以“科技创新、技术报国”为宗旨，以“专注技术、强调质量、服务客户”为经营理念，致力于成为在全球半导体级硅材料及其制品领域内，有市场地位、有技术优势和研发实力、有高性价比产品、有良好品质管理及售后服务的优秀硅材料供应商。公司将继续着眼于国际半导体行业，引进有着丰富生产、管理

经验的复合型专家；同时吸纳国内有一定基础的中端技术人员；巩固并加强中国本土技术人才梯队，提升公司的人才竞争优势。

（一）大直径硅材料

在研发方面，公司将紧跟行业前沿客户的研发步伐，继续优化最大至 22 英寸的大直径单晶硅材料的工艺手段，提升成品率和产量。同时不断地深化多晶质硅材料制造技术，提高多晶硅材质硅零部件的加工产能；在市场开拓方面，公司将继续深耕重点客户，在巩固与重点客户长期稳定的良好合作关系同时，注重与国内半导体行业新兴设备厂商及终端集成电路客户的接触，逐步发展国内的销售网络，抓住国内半导体行业发展的机遇，扩大国内市场销售的份额；在产能方面，公司发挥技术优势，通过工艺改进和设备升级来增加产量。行业下行周期是扩大产能的最佳时机，公司将根据下游客户的订单及市场预期，适时地扩大生产规模，一方面能保证稳定的产品交付能力，一方面也为公司未来业绩增长奠定基础。

（二）硅零部件

在研发方面，公司紧随全球硅零部件产品的研发趋势，将继续与国内等离子刻蚀机制造厂商共同研发硅零部件产品，并深度服务国内终端集成电路制造厂商，持续推进定制研发和送样认证，继续扩展硅零部件图纸库和技术规格数据库；在市场开拓方面，随着国内 12 英寸集成电路制造产能的持续扩张，更多机台工艺进入成熟状态，硅零部件需求将随之增长，公司将抓住机会继续推进客户端评估，公司将“积少成多”，推动更多硅零部件规格进入评估认证；在产能方面，硅零部件产品规划的设计产能居全国领先地位，公司将加快在锦州建设硅零部件加工场所进度，提高从原材料到成品的技术生产衔接，加强研发团队针对各种加工方法的反馈速度和反馈强度，锦州硅零部件工厂建成后，公司南北两处厂区的布局可以更好地服务国内市场。

（三）半导体大尺寸硅片

在研发方面，公司将与国内重掺外延硅片厂商形成差异化竞争，继续发挥公司在晶体生长方面的独特优势，深化轻掺低缺陷硅片方面的技术工艺研发，对标国内主流集成电路制造厂商大量使用的硅片，快速提高产能，以满足该规格硅片的国内大批量需求。此外，公司还将根据集成电路制造厂商提供的具体技术要求，持续优化超平坦硅片、超高电阻硅片、氩气退火片等特殊工艺轻掺硅片，发挥公

司技术优势，占据一系列利润率较高的细分硅片市场。在市场开拓方面，公司将继续加大力度推进主流集成电路制造厂商的评估认证工作，力争在年内得到主流集成电路制造厂商的正片评估通过结果并取得小批量订单；在产能方面，公司大力推动产品评估认证工作，已达到规模化生产状态的一期 5 万片/月的设备，力争达到与业内先进厂商同等的良品率。公司订购的每月 10 万片的硅片加工设备陆续进场，开展安装和调试工作为批量生产做准备。公司坚持稳扎稳打、不骄不躁的理念，生产规模的扩展既要满足工艺稳定、较高良率的要求，又满足客户送样认证及批量订货之所需。另外，公司将继续优化 12 英寸硅片级晶体的技术参数。争取早日实现 12 英寸硅片的试生产。

未来，公司将继续依托自身的技术优势及丰富的半导体市场经验，增加技术研发投入，提高生产管理效率，并紧密围绕国家战略，成为中国乃至世界半导体硅材料领域的领先者。

四、经营计划

近年来，国内半导体材料市场快速发展。根据 WSTS 数据，2022 年中国大陆半导体市场规模达 1803 亿美元，为世界第一。虽然中国半导体行业整体销售规模庞大，但半导体材料及设备依然严重依赖进口，无法满足国内快速增长的市场需求。

2023 年，公司拟定如下经营目标：

（一）大直径硅材料领域

公司将抓住行业下行周期的窗口期，积极扩大大直径硅材料产品的产能规模，结合客户的订单预期以及行业未来几年的发展需求，完成生产厂房的基础建设工作，适时扩大设备产能；通过工艺改进和设备升级等多方面手段来增加既有生产设备的单炉次产量，有效地控制成本；发挥公司特有的晶体生长技术优势，确保产品品质上的稳定性、一致性，保持国际上的领先地位。

多晶质硅材料及其制成品方面，在稳定工艺窗口的基础上，根据客户评估进度以及订量数量，公司将增加多晶质制成品的加工产能，稳步提高月产量，形成一定规模的销售收入。

同时，公司将加深与客户端的研发合作，特别是针对下一代等离子刻蚀机对大直径材料提出的严苛指标，开展更多研发工作，做好技术储备。

（二）硅零部件领域

国内 12 英寸集成电路制造厂商需求快速增长带动，中国本土半导体供应链安全需求迫切，公司的硅零部件产品已经进入长江存储、福建晋华等中国领先的本土存储类集成电路制造厂商供应链，未来将获得更多国内客户的评估认证机会，并形成更多稳定的批量订单。

为保证客户订单的及时交付，公司将扩大生产规模，做好设备采购、安装调试等前期准备工作，确保实现较快速度的产能爬升；公司将加快在锦州建设硅零部件工厂的进度，公司南北两处厂区的布局可以更好地服务全国市场；集中力量，针对国内 12 英寸集成电路制造厂商的特殊硅零部件需求，展开更多品种硅零部件的研发工作；年内全面实现向国内头部存储类集成电路制造厂商的批量化、规模化供货，实现硅零部件产品收入稳步提升。

（三）半导体大尺寸硅片领域

公司将确保更高产量条件下的高良率水平，现有生产设备逐步达到最大产能；随着已订购设备的陆续进场，安装调试等工作的进行，公司半导体大尺寸硅片产能将继续稳健扩充。

公司将根据下游客户的技术要求，深化低缺陷路线下的高技术含量及高毛利优势产品的研发及批量生产工作，如轻掺高阻硅片、氧化片、超平坦硅片、氩气退火片等。公司对标国际一流厂商某款销量较大的轻掺低缺陷硅片的产品，争取年内获得国内主流集成电路制造厂认证通过并形成小批量订单。

公司将继续探索并积累 12 英寸半导体级低缺陷晶体的生长工艺。

公司将加紧推进此前受特殊原因影响而推迟的部分硅片客户的验厂工作，抓住下游客户多样化的产品需求和供应链安全需求，取得更多订单，继续提升品牌知名度和客户信任度，实现业绩稳步增长。

（四）人才梯队建设

公司计划未来将股权激励作为常态化的激励机制，继续引进具备丰富生产、管理经验的复合型专家和技术人员，扩充到现有的中、高级管理人员团队，加强建设高水平人才梯队，持续提升人才竞争优势。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

议案三：**《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》**

各位股东和股东代表：

2022 年度，公司监事会本着对全体股东负责的精神，按照《公司法》《证券法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定和要求，谨慎、认真地履行自身职责，独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开监事会六次，监事会成员列席了报告期内的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

一、监事会会议召开情况

2022 年度，公司召开 6 次监事会，公司董事会按照《公司法》等法律法规的规定以及《公司章程》等相关制度的要求，根据公司发展需要及时召开董事会会议，将各项会议议案提交董事会审议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第二届监事会第四次会议	2022 年 2 月 14 日	审议通过 1、关于<公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案 2、关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。
第二届监事会第五次会议	2022 年 3 月 3 日	审议通过 1、关于向激励对象首次授予限制性股票的议案 2、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案。
第二届监事会第六次会议	2022 年 4 月 18 日	审议通过 1、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案 2、关于 2021 年度监事会工作报告的议案 3、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案 4、关于公司 2021 年度利润分配方案的议案 5、

		关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案 6、关于 2022 年度监事薪酬方案的议案 7、关于公司 2021 年度募资资金实际存放与使用情况的专项报告的议案 8、关于注销部分募集资金专用账户的议案 9、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。
第二届监事会第七次会议	2022 年 4 月 25 日	审议通过 1、关于公司 2022 年第一季度报告的议案。
第二届监事会第八次会议	2022 年 8 月 29 日	审议通过 1、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案 2、关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 3、关于开展远期外汇交易业务的议案 4、关于向金融机构申请综合授信额度的议案 5、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 6、关于公司聘请 2022 年度审计机构的议案。
第二届监事会第九次会议	2022 年 10 月 25 日	审议通过 1、关于公司 2022 年第三季度报告的议案。

二、公司相关事项的规范运作

2022 年度，公司监事会全体监事按照规定列席了公司董事会和股东大会，并对公司治理情况、财务情况等相关重要事项进行了监督和核查，具体情况如下：

1、公司治理情况

2022 年度，公司股东大会、董事会严格依照《公司章程》和相关法律法规行使职权。会议的召集、召开、表决和决议等程序合法有效。各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。2022 年度，公司董事、高级管理人员充分依照法律及公司制度的规定履行职责，不存在违反法律法规或损害公司和股东利益的行为，确保了公司生产经营平稳顺利运行，维护了广大股东的利益。

2、公司财务情况

2022 年度，公司监事会通过听取公司财务负责人的专项汇报等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。监事会认为公司财务运作规范，公司财务报告客观、真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2022 年度审计报告内容真实、客观，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、公司关联交易情况

2022 年度，公司未发生需要经董事会审议的关联交易事项。公司不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

4、公司对外担保及关联方资金占用情况

2022 年度，公司未发生对外担保、控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。

5、公司募集资金使用与管理情况

2022 年度，公司监事会对募集资金存放与使用情况进行了核查。监事会认为公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

三、监事会 2023 年年度工作计划

2023 年度，监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，结合公司业务发展实际，有效防范和控制风险，进一步促进公司的规范运作。同时不断加强自身学习，忠实履行职责，持续依法行使监事会各项职权，监督公司依法运作情况、审核定期报告、检查公司财务、对董事和高级管理人员执行公司职务的行为进行有效监督和检查、依法出席或列席股东大会、董事会会议及相关会议，知悉并监督各重大决策事项及其履行程序的合规性，为维护公司及全体股东的合法权益做出不懈的努力。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

议案四：

《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

各位股东和股东代表：

为更全面、详细地展现公司 2022 年的财务状况和经营成果，现将公司 2022 年度财务决算情况报告如下：

2022 年度，锦州神工半导体股份有限公司年财务报告经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚审字[2023]110Z0019 号标准无保留意见的审计报告，公司财务决算情况如下：

一、2022 年总体经营业绩回顾

报告期内，公司实现营业收入 539,236,503.68 元，其中大直径硅材料 16 寸以下产品实现收入 338,293,281.35 元，比上年同期减少 2.52%；大直径硅材料 16 寸以上产品实现收入 137,814,619.69 元，比上年同期增加 3.60%；硅零部件、硅片等实现收入 26,551,481.30 元，比上年同期增加 362.15%。实现营业利润 177,571,326.98 元，较上年同期减少 30.57%；归属于上市公司股东的净利润 158,141,626.89 元，较上年同期减少 28.44%；经营活动产生的现金流量净额为 130,146,507.24 元，较上年同期减少 31.19%。

注：2021 年数据已考虑会计政策变更导致的影响，下同。

二、报告期内公司经营业绩分析

1、资产、负债状况

公司 2022 年末总资产 1,759,658,594.62 元，同比增加 17.75%；负债总额 145,998,605.02 元，同比增加 91.38%；归属于上市公司股东的所有者权益总额 1,573,266,430.97 元，同比增加 10.94%；资产负债率为 8.30%。

其中，（1）货币资金较上期末增加 43.03%，主要系销售收入增加、理财赎回增加、少数股东增资等综合影响导致公司现金余额增加所致；（2）交易性金

融资产较上期末减少83.17%，主要系公司理财规模减少，对应资金流入减少所致；

（3）应收账款较上期末增加92.17%，主要系本期收入增长所致；（4）预付款项较上期末减少48.40%，主要系预付款购买原材料减少所致；（5）固定资产较上期末增加19.47%。（6）在建工程较上期末增加300.89%，主要系募投项目持续投入，产能扩展相关工程项目逐渐增加，本期新增投入设备调试尚未完成综合影响所致；（7）其他非流动资产较上期末增加38.38%，主要系购买设备、在建工程等长期资产增加所致；（8）递延所得税资产较上期末增加130.51%，主要系新增股份支付产生的可抵扣暂时性差异增加和租赁事项可抵扣暂时性差异增加所致；（9）应付账款较上期末增加150.83%，主要系公司采购规模增加所致；（10）应交税费较上期末增加23.45%；（11）递延收益较上期末减少2.60%。

2、期间费用及所得税费用分析

单位：元 币种：人民币

费用项目	2022年度	2021年度	同比增减幅度（%）	2020年度
销售费用	4,873,957.55	4,510,689.65	8.05	2,954,826.91
管理费用	39,367,112.49	35,266,183.82	11.63	22,898,281.12
财务费用	-11,608,676.14	-10,738,051.34	不适用	-12,105,207.68
研发费用	39,375,904.62	53,326,649.43	-26.16	17,577,539.39

销售费用变动原因说明：销售费用较上年同期增长8.05%，主要系公司加大客户开发力度，积极搭建硅零部件、硅片的销售网络，及评估认证过程中的免费样品费用增加所致。

管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增长11.63%，主要系公司新增股份支付费用，以及硅片产品生产规模扩大所致。

研发费用变动原因说明：研发费用较上年同期减少26.16%，主要系公司部分在研项目结题，研发费用阶段性投入变化所致。

3、现金流量状况

单位：元 币种：人民币

项目	2022年	2021年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	565,140,637.78	570,913,518.86	-1.01
经营活动现金流出小计	434,994,130.54	381,788,232.99	13.94
经营活动产生的现金流量净额	130,146,507.24	189,125,285.87	-31.19
投资活动现金流入小计	756,254,530.24	439,055,303.57	72.25
投资活动现金流出小计	793,767,794.37	698,802,231.97	13.59
投资活动产生的现金流量净额	-37,513,264.13	-259,746,928.40	不适用
筹资活动现金流入小计	101,088,396.29	1,825,819.84	5436.60
筹资活动现金流出小计	74,055,608.06	17,819,843.80	315.58
筹资活动产生的现金流量净额	27,032,788.23	-15,994,023.96	不适用
现金及现金等价物净增加额	118,224,076.57	-90,336,965.90	不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原始多晶硅等主要原材料价格大幅上涨，公司采购费用增加，付现支出增加所致。

4、主要数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

	2022年	2021年	本年比上年 增减(%)	2020年
营业收入	539,236,503.68	503,551,819.77	7.09	193,497,723.19
归属于上市公司股东的净利润	158,141,626.89	220,992,902.56	-28.44	101,653,865.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,736,626.54	216,676,597.50	-28.59	91,021,822.32
经营活动产生的现金流量净额	130,146,507.24	189,125,285.87	-31.19	144,923,040.49
基本每股收益(元/股)	0.99	1.38	-28.26	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.99	1.38	-28.26	0.63
净资产收益率(%)	10.84	16.80	-5.96	9.74

	2022 年末	2021 年末	本年末比 上年末增 减(%)	2020 年末
归属于上市公司股东的净资产 (归属于上市公司股东的所有 者权益)	1,573,266,430.97	1,418,104,401.42	10.94	1,213,224,034.42
总资产	1,759,658,594.62	1,494,391,913.36	17.75	1,349,945,158.95

公司 2022 年实现营业收入 53,923.65 万元，同比增长 7.09%。公司积极把握市场机遇、持续优化产品结构、稳步扩大生产规模、通过完善众多关键技术指标实现全球领先的竞争优势，满足客户对品质的严苛要求。

公司 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 15,814.16 万元，同比减少 28.44%。受主要原材料原始多晶硅价格大幅增长影响，公司生产成本相应增加、实施股权激励后新增股份支付费用。受上述多重因素影响，公司营业利润有所下降。

公司 2022 年经营活动产生的现金流量净额同比减少 31.19%。主要系原始多晶硅等主要原材料价格大幅上涨，公司采购费用增加，付现支出增加所致。

公司 2022 年基本每股收益、稀释每股收益同比减少 28.26%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少 28.15%，主要系报告期内归属于上市公司股东的净利润减少所致。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

议案五：

《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

各位股东和股东代表：

根据公司 2023 年度生产经营和发展计划，结合宏观环境、行业趋势、市场状况，现将公司 2023 年度财务预算情况报告如下：

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为锦州神工半导体股份有限公司及其下属子公司（以下简称“公司”）。本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合 2023 年度公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划等，按照合并报表口径进行测算并编制。

二、预算编制基本假设

1. 公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和有关优惠政策无重大变化；
2. 宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；
3. 国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；
4. 公司的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足、市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；
5. 无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2023 年度主要财务预算指标

公司结合国内外半导体行业市场环境发展趋势，制定了 2023 年财务预算目标。力争通过提升自有技术优势、合理节约成本开支、优化企业资源配置等手段，实现整体营业收入或净利润较上年同期稳步增长，硅零部件业务实现较快增长。

四、风险提示

上述财务预算仅为公司 2023 年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场

状况变化等多种因素，存在较大不确定性，投资者对此应当保持足并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

议案六：

《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

各位股东和股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币 158,141,626.89 元，公司期末可供分配利润为人民币 419,549,108.75 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 160,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,000,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 10.12%。公司不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司行业特点、公司经营模式、盈利水平、资金需求、发展阶段、以及未来可能面临的风险等方面，兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，有利于为投资者获取更大价值，保障公司稳健发展，不存在损害中小股东利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

公司已于 2023 年 3 月 18 日披露了《锦州神工半导体股份有限公司关于 2022 年年度利润分配方案的公告》，具体内容可在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》查阅。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

议案七：

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货业务相关业务资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和内部审计的工作需求。董事会拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度财务报告及内部控制的审计机构，聘期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会结束时止。2023 年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据前述情况与容诚会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于 2023 年 3 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《锦州神工半导体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

议案八：

《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议案》

各位股东和股东代表：

为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要，充分调动董事的积极性和创造性，促进公司稳健、有效发展，根据《公司法》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制定 2023 年度公司董事薪酬方案如下：

非独立董事：公司董事在公司担任具体职务的，根据其所担任的具体职务，依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，公司不额外向非独立董事支付董事职位薪酬。

独立董事：公司向独立董事支付津贴，标准为每人 12 万元/年（税前）。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

议案九：

《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

各位股东和股东代表：

公司制定了 2023 年度监事薪酬方案如下：

公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不额外向监事支付监事职位薪酬。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日

议案十：

《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

各位股东和股东代表：

现提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，本次授权事宜包括但不限于以下内容：

1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

2、发行股票的种类、面值和数量

本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合法投资组织，发行对象不超过35名（含35名）。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

4、定价方式或者价格区间

（1）本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日

股票交易总量)。

(2) 向特定对象发行的股票,自发行结束之日起六个月内不得转让;发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的,其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。

5、募集资金用途

公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下规定:

(1) 符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定;

(2) 除金融类企业外,本次募集资金使用不得为持有财务性投资,不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司;

(3) 募集资金项目实施后,不会与主要股东及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司生产经营的独立性;

(4) 发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务。

6、发行前的滚存利润安排

本次发行股票后,发行前公司滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共享。

7、股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

8、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下,全权办理以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜,包括但不限于:

(1) 根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求,结合公司的实际情况,制定、调整和实施本次发行方案,包括但不限于发行的实施时间、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜;

(2) 办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜,并根据相关法律法规、规范性文件以及股东大会作出的决议,结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况,对募集资

金投资项目及其具体安排进行调整；

(3) 办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据上海证券交易所及中国证券监督管理委员会的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与发行相关的材料，回复上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照监管要求处理与发行相关的信息披露事宜；

(4) 签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于承销与保荐协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和重要文件；

(5) 设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

(6) 根据相关法律法规、监管要求和发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；

(7) 在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

(8) 根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，在法律、法规及规范性文件和《公司章程》及股东大会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜；

(9) 决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

(10) 在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

(11) 在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等的影响，制订、修改相关的填补措施与政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

(12) 在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行相关的其他事宜。董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的前提下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

9、决议的有效期

本项授权决议有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至公司2023年年度股东大会召开之日止。

上述议案请各位股东和股东代表审议。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2023 年 4 月 10 日